

1. 典型性能指标

| 测试项目 | 单位 | 典型值 |
|---------------|-------------------------|--------------|
| 环保或非环保 | | 环保 |
| 外观 | | 黑色 |
| 树脂类型 | | EOCN/DCPD+PN |
| 填料类型 | | 角形 |
| 填料含量 | % | 76 |
| 填料最大尺寸 | um | 180 |
| 阻燃 UL-94@1/4" | | V-0 |
| 胶化时间 | s | 26 |
| 流动长度 | inch | 27 |
| 玻璃化转变温度 Tg | °C | 175 |
| 热膨胀系数 1 | ppm | 13 |
| 热膨胀系数 2 | ppm | 59 |
| 弯曲强度@25°C | Mpa | 119 |
| 弯曲模量@25°C | Mpa | 13695 |
| 吸水率(PCT24h) | % | 0.52 |
| 比重 | g/cm3 | 1.84 |
| 导热系数 | W/m.K | 0.67 |
| 成型收缩率 | % | 0.25 |
| 体积电阻率@25°C | × 10 ¹⁵ Ω.cm | 40 |
| 电导率 | μs/cm | 43 |
| pH | | 5.7 |
| 氯离子含量 | ppm | 9 |
| 钠离子含量 | ppm | 6 |

2. 成型及后固化条件

| | | |
|--------|-----|---------|
| 封装模具类型 | | 传统模 |
| 模塑温度 | °C | 170-190 |
| 模塑固化时间 | sec | 90-150 |
| 后固化温度 | °C | 175 |
| 后固化时间 | h | 4-8 |

3. 运输储存条件/有效期

| | |
|--------|-------|
| 运输储存条件 | 5°C以下 |
| 有效期 | 12个月 |

备注：以上数据基于上海道宜半导体材料有限公司实验室测试结果，非保证值，典型值仅供参考。